스몰캡

권명준 스몰캡
myoungchun.kwon@yuantakorea.com
서석준 Research Assistant
seokjun.seo@yuantakorea.com

Necessity is the mother of invention

AI 적용 확대로 데이터 처리량이 증가, 이로 인해 HBM 외에도 메모리 반도체內 다양한 신기술들이 도입될 것으로 예상된다.

HBF

본문 HBF는 디램보다 속도는 느리지만 용량이 큰 낸드플래시 메모리를 HBM처럼 3차원으로 쌓아 구멍을 뚫고 통로를 설치해 통합하는 구조이다. 메모리 병목 현상을 해결할 수 있는 대안으로 등장한 것이 HBF이다. AI가 추론 위주로 시장이 변화되면서 대량 데이터를 한번에 옮기는데 최적화된 플래시 기반 메모리 가능성이 주목받고 있다.

CXL

CXL은 CPU와 메모리, 가속기 등 다양한 고성능 컴퓨팅 장치 간의 효율적인 상호 연결을 위한 개방형 고속 인터페이스 기술이다. 기존 PCIe 인터페이스 기반 인터페이스의 한계를 극복하고, 고대역폭, 고속 & 저지연을 통해 데이터 처리 성능을 향상시킬 수 있다. CXL의 필요성이 제기된 이유는 데이터 처리량 증가에 기인한다. Big Data, AI, Cloud Computing 등 데이터 중심의 애플리케이션이 급증함에 따라 데이터 처리량과 메모리 용량 확장에 대한 요구도 증가한다.

소켐2

엔비디아가 주도적으로 제안하고 주요 메모리 제조사가 공동으로 개발 중인 새로운 메모리 폼팩터로, LPDDR5X 기반의 저전력 고대역폭 특성을 서버 환경에서도 유연하게 활용할 수 있도록 설계되었다. AI 추론 비중이 확대되면서 메모리내 고대역폭과 낮은 전력 소모가 동시에 요구되는 상황이 연출되고 있다. 엔비디아가 2H26 출시할 것으로 예상되는 베라 루빈내 소캠2가 탑재될 것으로 예상됨에 따라 시장의 주목을 받고 있다.

테스트 소모품 기업

새로운 기술 도입은 장비/소재 등 다양한 영역에서의 변화를 야기할 뿐만 아니라 테스트 장비 및 테스트를 위한 소모품(소켓, 보드, 핀 등)에도 큰 변화를 유발한다. 국내 메모리 반도체 테스트 소모품 기업들의 경우 지속적인 고객사 대응을 통해 국내 기업들로 구성되어 있으며, 신규 공정에 대한 R&D도 고객사와 진행하고 있는 것으로 알려져 있다. 테스트 소모품 업체들은 이와 같은 변화가 ASP를 개선시킬 수 있는 기회요인으로 작용될 것으로 예측된다는 점에서 주목할 필요가 있다고 판단된다. 오킨스전자(080580), 마이크로컨텍솔(098120), 티에스이(131290) 등이 이에 해당된다.

종목	투자의견	목표주가 (원)
오킨스전자	Not Rated (M)	(M)
마이크로컨텍솔	Not Rated (I)	(I)
티에스이	Not Rated (I)	(I)

HBF

HBF(High Bandwidth Flash)란?

HBF는 디램보다 속도는 느리지만 용량이 큰 낸드플래시 메모리를 HBM처럼 3차원으로 쌓아 구멍을 뚫고 통로를 설치해 통합하는 구조이다.

HBF가 필요한 이유 및 주목받는 배경.

AI 서비스를 동시에 사용하는 이용자가 급증하고 있다. AI 산업의 무게중심이 단순 학습을 넘어 인간처럼 생각하는 추론으로 이동하고 있다. 이로 인해 처리해야 할 데이터가 기하급수적으로 늘고 있다.

GPU는 병렬 처리 연산에 특화된 프로세서로 AI 학습이나 추론에 적합하다. HBM은 GPU 연산에 필요한 데이터와 연산 결과를 고속 송수신하며 AI 성능을 개선하고 있다. 하지만, HBM만으로 GPU의 연산 속도를 따라가지 못하고 있다. 즉, 메모리 병목 현상이 발생하고 있다. 참고로 AI 작업 수행시 GPU가 계산하는 시간 점유율은 약 20~30% 수준으로 알려져 있다.

AI 추론은 맥락을 기억하며 판단을 이어가는 구조이다. 이전 대화와 판단한 결과, 작업 맥락 등 방대한 중간 데이터를 지속적으로 저장, 불러오는 능력이 중요해진다. HBM은 제한적인 용량, 고가의 제품이라는 점을 감안시 추론 과정에서 HBM만을 사용하는데 비용적 부담감이 발생한다는 것을 의미한다.

참고로 HBM은 메모리 칩 위에 수직 적층해 대역폭과 용량을 늘린 기술이다. 적층 단수에 한계가 있으며, 제조 난이도가 높고, 적층수 증가시 공정난이도 상향에 따른 생산원가가 상향된다는 단점들이 제기된다.

메모리 병목 현상을 해결할 수 있는 대안으로 등장한 것이 HBF이다. HBF는 낸드플래시를 기반으로 읽기속도를 극대화한 새로운 메모리 구조이다. HBM은 휘발성 메모리인 반면, HBF는 대용량 데이터를 안정적으로 저장하는 비휘발성 메모리이다. 낸드플래시는 SSD 등에 쓰이는 대용량, 저가형 저장장치로 반응속도가 HBM 대비 1,000배 이상 느리다는 단점이 있다. 하지만 AI가 추론 위주로 시장이 변화되면서 대량 데이터를 한번에 옮기는데 최적화된 플래시 기반 메모리 가능성이 주목받고 있다.

카이스트 김정호 교수에 따르면, HBF는 단독 메모리가 아니라 HBM과 결합된 계층형 구조로 진화될 것으로 예상한다. HBM이 빠른 연산을 보조, HBF는 AI가 처리하는 방대한 데이터를 대용량으로 저장하는 역할을 수행할 것이다.

HBF는 HBM이 처리할 수 없는 대용량 데이터를 네트워크로 연결된 데이터센터에서 전송, 데이터 일부를 가져와 GPU옆에 붙여주는 형태이다. 즉, GPU는 HBM, HBM은 HBF와 데이터를 주고받는 형태이다. HBF는 AI시스템의 확장성을 높이면서도 전체 운영 비용을 줄일 수 있을 것으로 예상된다.

HBF의 예상 개화시점

HBF를 포함한 복합 메모리 솔루션에 대한 수요가 2027년 제품 출시, 2030년 전후로 본격 확대될 것으로 예상된다.

IB업계에서 글로벌 HBF시장은 2027년 10억달러 규모에서 2030년 120억달러 규모로 성장할 것이며, 2030년 전후로 본격적인 성장궤도를 진입할 것으로 전망하고 있다는 뉴스가 보도된바 있다.

SK하이닉스와 샌디스크 연합은 2025년 8월 HBF 기술 사양 공동으로 정의하고 표준화 추진 MOU를 체결했으며, 26년 하반기 HBF 메모리샘플을 출시, HBF를 탑재한 최초의 AI 추론 시스템을 27년초에 선보인다는 계획이다.

카이스트 김정호 교수는 HBF의 상용화 시점으로 2027년말~2028년으로 예상한다. 2038년에는 HBF의 비중이 HBM보다 커질 것으로 전망한바 있다.

HBF 개선 필요사항

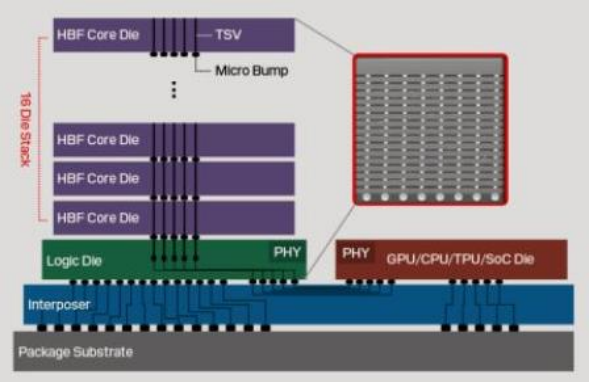
HBF에는 속도, 신뢰성, 플래시의 느린 반응속도, 낮은 내구성 등의 개선사항들이 존재한다.

속도. HBF는 낸드 플래시 기반으로 구조적으로 디램대비 접근 시간이 길다.

수명. 디램은 사실상 수명 제한이 없는 반면, 낸드는 약 10만번 정도를 사용하면 수명이 다한다.

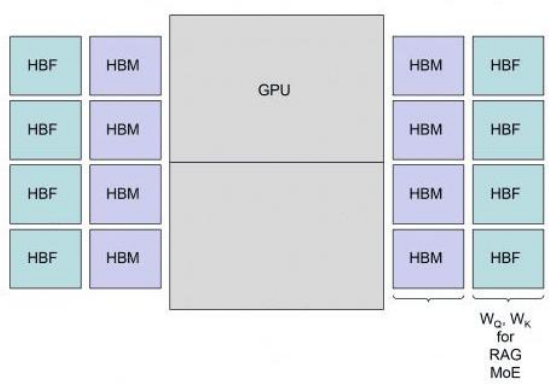
소재. 현재 낸드 기술은 전자를 가둬 정보를 기록하는 쓰기 과정을 반복하면, 소재 결함 등이 자연적으로 발생한다. 이로 인해 오류가 발생되는 것으로 알려져 있다.

[그림 1] HBF 구조



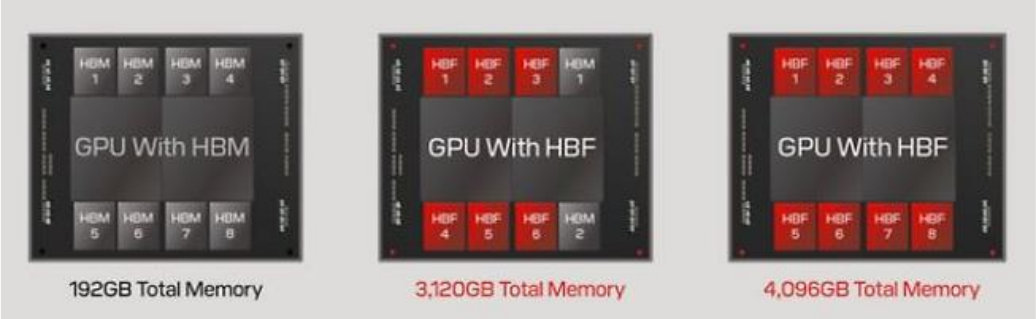
자료: 샌디스크, 유안타증권 리서치센터

[그림 2] GPU와 HBM, HBF 결합 예상



자료: KAIST, 유안타증권 리서치센터

[그림 3] HBM VS. HBF



자료: 유안타증권 리서치센터

HBF 관련 글로벌 기업들의 행보

①SK 하이닉스-샌디스크

25.02월 샌디스크 AI 용 차세대 메모리 HBF 공개했다. HBF 를 AI 추론 및 고성능 컴퓨팅 환경을 위한 솔루션으로 제시한 것이다. 1세대 HBF 는 16개의 HBF 코어 다이를 포함, GPU 에서 최대 4TB 의 VRAM 용량을 제공할 수 있도록 설계되어 있다. 독자적인 적층 기술을 적용해 16개의 HBF 코어 다이를 쌓으면서도 최소한의 기판 휘어짐을 유지할 수 있도록 되어있다. 8개의 HBF 스택이 총 4TB 낸드 메모리를 제공(각 스택이 512GB 저장)하여 HBM3E(24GB)와 비교시 21배 더 많은 용량을 제공할 수 있다는 특징이 있다.

2026.02.26일. SK 하이닉스와 샌디스크가 미국 샌디스크 본사에서 HBF Spec 표준화 컨소시엄 킥오프 행사를 열고, HBF(High Bandwidth Flash)의 글로벌 표준화 전략을 발표했다.

②삼성전자

삼성전자 역시 HBF 개발에 착수한 것으로 알려져 있다. SEDEX 2025에서 핀펫 기술을 활용한 새로운 낸드플래시를 개발 중이라고 밝혔다는 점에서 HBF 에 파운드리 기술을 적용할 것으로 예상된다.

③YMTC

올해 연초 중국 반도체 산업 협회와 공동으로 발표한 기술 문서를 통해 AI가속기 및 고성능 컴퓨팅 워크로드에 최적화된 새로운 메모리 로드맵을 공개했다. HBF등이 포함되어 있다. YMTC가 HBF 시장 선점을 자신하는 배경에는 1)메모리 셀과 주변 회로를 서로 다른 웨이퍼에서 제조한 뒤 결합하는 독자적인 Xtacking 아키텍쳐 기술이 있으며, 2)하이브리드 본딩 분야에서 다수의 양산 경험을 보유하고 있다는 사항이다.

CXL

CXL(Compute Express Link)란?

CXL은 CPU와 메모리, 가속기 등 다양한 고성능 컴퓨팅 장치 간의 효율적인 상호 연결을 위한 개방형 고속 인터페이스 기술이다. 기존 PCIe 인터페이스 기반 인터페이스의 한계를 극복하고, 고대역폭, 고속 & 저지연을 통해 데이터 처리 성능을 향상시킬 수 있다.

참고1. PCI는 1992년 인텔이 개발한 확장 카드 슬롯 규격으로 CPU와 GPU 등 주변장치를 연결하는 역할을 한다. PCIe는 기존 PCI 방식의 한계(속도와 확장)을 개선한 차세대 인터페이스이다. PCIe는 직렬 방식을 사용하여 데이터를 전송하며, 각 슬롯이 독립적인 데이터 경로를 가질 수 있다.

참고2. PCIe가 CPU와 GPU 등 주변장치를 연결하는 반면, GPU와 GPU간의 연결하는 인터너켁트는 NVLink를 통해 이뤄진다. PCIe대비 넓은 대역폭을 제공한다. GPU가 증가함에 따라 GPU를 일일이 직접 연결하는 것이 비효율적으로 됨에 따라 다수의 NVLink 포트를 보유한 전용 스위치 칩인 NV Switch을 통해 GPU간의 연결을 효율화하고 있다.

CXL의 메모리 공유 지원 방식은 다음과 같다. 첫째, 메모리 풀링(Pooling)이다. CXL은 다수의 호스크가 동일한 물리적 메모리 풀을 공유할 수 있도록 지원한다. 이로 인해 각 호스트는 자신의 필요에 맞는 메모리를 동적으로 할당받고 해제할 수 있다. 메모리 지원의 활용도 및 유연성이 개선된다. 둘째, 캐시 일관성이다. CXL는 CPU와 연결된 장치 간의 캐시 일관성을 유지하여, 데이터가 여러 장치간에 일관되게 유지될 수 있도록 지원한다. 데이터 이동을 축소시켜 성능 향상에 기여한다. 셋째. 다중 호스트 지원이다. 여러 호스트가 하나의 메모리 공간을 일관되게 공유할 수 있는 기능을 제공하여 아키텍처의 유연성을 향상시키며, 서버 간의 자원 공유를 통해 TCO(총 소유 비용)을 절감할 수 있다.

[그림 4] CXL

자료: 삼성전자, 유안타증권 리서치센터

CXL(Compute Express Link)이 주목받는 이유

CXL의 필요성이 제기된 이유는 데이터 처리량 증가에 기인한다. Big Data, AI, Cloud Computing 등 데이터 중심의 애플리케이션이 급증함에 따라 데이터 처리량과 메모리 용량 확장에 대한 요구도 증가한다.

반면 기존 PCIe 기반 인터페이스는 메모리 확장 및 공유에 제약이 존재한다. GPU, CPU, FPGA 등 다양한 이종 컴퓨팅 장치의 통합 및 효율화를 위해 새로운 인터페이스가 필요한 상황이다.

대규모 언어 모델은 KV 캐시(단기 기어장치)만으로도 GPU당 80~120GB를 차지하는 경우가 많아, HBM 탑재 가속기로는 감당하기 어려운 상황이다. CXL 메모리 확장 기술은 서버가 CPU 연결, DRAM 한계를 넘어 메모리 풀에 접근할 수 있게 함으로써 메모리 용량 위기를 직접 해결한다. CXL 표준화를 통해 CPU, GPU, 디램과 스토리지가 모두 일관된 프로토콜 안에서 직접적인 소통이 가능해진다.

CXL(Compute Express Link) 버전

CXL 1.0. 2019년에 출시되었다. PCIe 4.0 인터페이스를 지원하며 최고속도는 16GT/s이다. 메모리 확장 및 캐싱 기능을 지원한다. 최대 용량을 128GB이다. 기본적인 메모리 확장 및 가속기 연결 기능을 제공한다.

CXL 2.0. 2021년에 출시, PCIe 5.0 인터페이스를 지원한다. 최대속도는 32GT/s이다. 네트워킹 기능을 지원하며, 최대용량은 256GB이다. 메모리 풀링(여러 장치간의 메모리를 공유, 자원활용도를 극대화하고 메모리 효율성을 향상), 영구 메모리 지원 등 기능을 강화했다.

CXL 3.0. PCIe 6.0 인터페이스를 지원할 예정이다. 향상된 전송 속도 및 지연 시간, 확장된 기능 및 보안의 특징을 보인다. 최대용량은 512GB이다. 대역폭이 확대되며, 스위치 기능, 향상된 메모리 풀링 등 기능을 제공한다.

CXL(Compute Express Link) 구성

CXL 메모리는 CXL 호스트 컨트롤러, CXL 메모리 익스팬더, CXL 메모리 모듈, CXL 스위치, CXL 캐시 등으로 구성되어 있다. CXL는 메모리에 데이터 접근 요청을 보낸다. CXL 호스트 컨트롤러는 CPU의 요청을 받아 메모리 접근을 관리한다. CXL 메모리 익스팬더는 CXL 메모리 모듈에 접근 요청을 전달한다. CXL 메모리 모듈을 요청받은 데이터를 CXL 메모리 익스팬더로 전송한다. CXL 호스트 컨트롤러는 CXL 메모리 익스팬더로부터 데이터를 받아 CPU로 전송한다. CPU는 받은 데이터를 처리하고 응답을 보낸다.

CXL(Compute Express Link)의 특징

장점은 다음과 같다. 첫째. 성능. CXL는 PCIe 5.0 인터페이스를 지원하며 최대 32GT/s의 전송 속도를 제공한다. 기존 PCIe 인터페이스대비 빠른 속도로 대용량 데이터 처리에 유리하다. CXL는 직접 연결방식을 사용하여 CPU와 메모리 사이의 지연시간을 단축, 지연시간에 민감한 애플리케이션의 성능 개선이 가능하다.

둘째, 확장성. CXL 메모리 익스팬더를 사용하여 기존 시스템에 CXL 메모리를 추가할 수 있다. CXL 스위츠를 사용하여 여러 CXL 장치를 연결, CXL 네트워크를 구성할 수 있어 시스템 확장성이 높다.

셋째. 낮은 전력소비. 에너지 효율적인 설계를 사용하여 전력 소비를 줄인다. CXL 메모리는 캐싱 기술을 사용하여 자주 사용하는 데이터를 메모리에 저장, CPU가 데이터에 접근하는데 필요한 전력을 감소시킬 수 있다.

넷째, 다양한 어플리케이션 지원. CXL 메모리는 인공지능, 고성능 컴퓨팅, 데이터 센터, 클라우드 컴퓨팅 등 다양한 애플리케이션에 활용될 수 있다. CXL 메모리는 NVMe 스토리지 드라이브, 네트워크 어댑터, 액셀러레이터 등 다양한 장치를 지원한다.

단점은 다음과 같다. 첫째, 가격. CXL 메모리는 초기 단계의 기술이기 때문에 가격이 비싸다. 둘째, 호환성. CXL 메모리는 아직 모든 시스템에 호환되지는 않는다. 셋째, 복잡성. 기존 DDR4 램보다 구조가 복잡하여 관리가 어려울 수 있다. CXL 메모리 시스템을 구성하고 관리하기 위해서는 전문 지식이 필요하다.

CXL(Compute Express Link)의 적용 분야

인공지능. 인공지능 애플리케이션은 대용량 데이터 처리를 필요로 한다. CXL 메모리는 높은 속도와 낮은 지연시간을 제공, 인공지능 애플리케이션 성능 향상에 기여할 수 있다.

고성능 컴퓨팅. 고성능 컴퓨팅에서는 대규모 시뮬레이션, 분석 등의 작업을 수행한다. CXL 메모리는 높은 성능과 확장성을 제공하여 고성능 컴퓨팅 분야의 작업을 빠르고 효율적으로 수행할 수 있다.

데이터 센터. 데이터 센터는 방대한 양의 데이터를 처리하고 저장한다. CXL 메모리는 데이터 센터의 메모리 용량을 확장하고 성능을 개선시킬 수 있다.

클라우드 컴퓨팅. 클라우드 컴퓨팅 환경에서는 여러 사용자가 서버 리소스를 공유한다. CXL 메모리는 클라우드 컴퓨팅 환경의 성능을 향상시키고, 리소스 활용도를 상향시킬 수 있다.

CXL(Compute Express Link) 시장규모

욜(시장조사기관)에 따르면 글로벌 CXL 시장규모는 2028년 약 150억달러 규모가 될 것으로 전망된다. 이 중 80%인 120억달러는 CXL 디램 시장이 차지할 것으로 예상된다.

CXL(Compute Express Link) 관련기업

삼성전자. 2021년 5월 업계 최초로 CXL 2.0 기반 128GB DRAM 개발을 시작했다. 2023년 5월에는 CXL 2.0 표준 기반의 디램을 개발했다. 2023.10월에는 CXL 메모리 익스팬더 출시했다. 2024.2월 레드햇과 CXL 메모리 동작 검증을 완료했으며, 2024년 3월에는 MemCon 2024(글로벌 반도체 학회)에서 CXL 기반 디램인 CMM-D, 디램과 낸드를 함께 사용하는 CMM-H, 메모리 풀링 솔루션 CMM-B 등 다양한 CXL 기반 솔루션을 공개했다. 2024년 2분기 CXL 2.0을 지원하는 CMM-D(CXL Memory Module DRAM, 256GB) 제품을 출시했다.

삼성전자는 CXL 컨소시엄을 결성한 15개 이사회 회원사(삼성전자, 알리바바 그룹, AMD, ARM, 시스코, 델 EMC, 구글 휴렛패커드, 화웨이, IBM, 인텔, 메타, MS, 엔비디아, 램버스) 중 하나로, 메모리 업체 중 유일하게 이사회 멤버로 선정되어 있다.

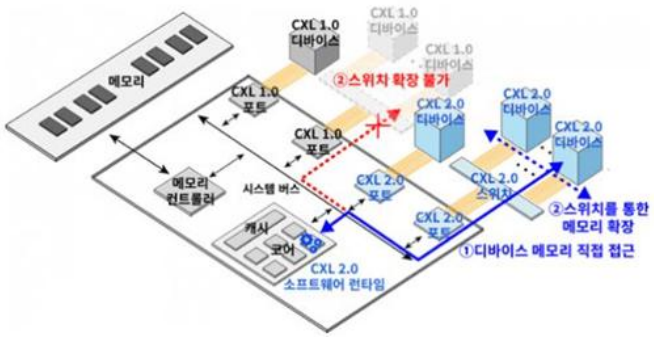
SK하이닉스. 2022년 CXL 2.0 기반 96GB급 디램 샘플을 공개했으며, 2023년 10월, CXL 2.0 기반 DDR5 메모리 모듈을 출시했다. 2025년 4월, CXL 2.0 기반 디램솔루션 CMM-DDR5(96GB) 제품의 고객 인증을 완료했으며, 128GB 제품도 다른 고객과 인증 절차를 진행하고 있다고 밝혔다.

마이크론. 2022년 5월 CXL 2.0기반 DDR 메모리 개발을 발표했다. 2023년 최대 256GB 용량을 지원하는 CXL 2.0 모듈을 출시한 바 있다.

인텔. CXL 컨소시엄을 주도해온 인텔은 2024년 6월 CXL 2.0을 지원하는 시에라포레스트(제온6)를 출시했다.

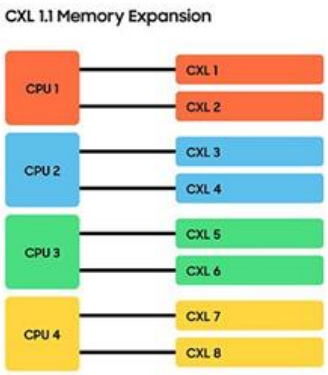
마이크로소프트. 2025년 11월 최초의 CXL 탑재 클라우드 인스턴스를 출시한다고 밝혔다. CXL 4.0 사양은 대역폭을 128GT/s로 2배 증가시킨다.

[그림 5] CXL 메모리 동작 특징



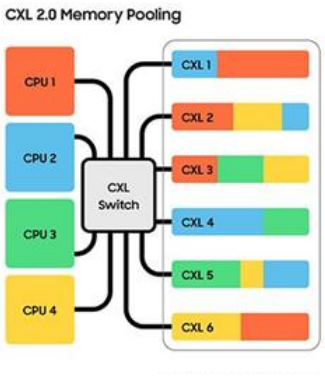
자료: KAIST, 유안타증권 리서치센터

[그림 6] CXL 1.1



자료: 삼성전자, 유안타증권 리서치센터

[그림 7] CXL 2.0



자료: 삼성전자, 유안타증권 리서치센터

[그림 8] CXL 이사회

자료: CXL, 유안타증권 리서치센터

소캠2(SoCAMM)

SoCAMM(Small outline Compression Attached Memory Module)란?

소캠은 서버용 메모리(RDIMM)처럼 꽂는 방식이 아니라 압착형 커넥터로 메인보드에 장착한다. AI 서버 등에서 고대역폭, 저전력 메모리를 소형 폼팩터로 제공한다. 기존 RDIMM 대비 소형, 저전력으로 HBM 대비 저렴하며. 범용성이 넓다.

엔비디아가 주도적으로 제안하고 주요 메모리 제조사가 공동으로 개발 중인 새로운 메모리 폼택터로, LPDDR5X 기반의 저전력 고대역폭 특성을 서버 환경에서도 유연하게 활용할 수 있도록 설계되었다.

소캠2가 주목받는 이유?

AI 추론이 비중이 확대되면서 메모리내 고대역폭과 낮은 전력 소모를 동시에 요구되는 상황이 연출되고 있다. 기존 서버용 메모리는 대부분 DDR5 RDIMM을 기반으로 하고 있다. 모듈당 128GB의 용량과 4,800~5,600MT/s의 속도를 지원하지만, 전력 소모가 크고, 슬롯 기반 확장에는 한계가 있다. 반면, 모바일에서 사용되는 LPDDR5X는 낮은 전력과 높은 대역폭을 제공하지만, 기기에 부착되어 있다는 점에서 교체나 업그레이드가 어려운 구조이다.

소캠은 이러한 두 기술의 장점을 결합한 구조이다. 전력 소모를 최소화하면서도 탈부착이 가능한 모듈형 설계를 통해 서버용 환경에 적합한 유연성과 유지보수 편의성을 제공한다.

소캠2는 소캠1대비 성능 및 전력 효율이 개선되었다. 대역폭 및 용량 확장성을 강화하여 AI 연산, LLM, GPU 서버에 채택될 것으로 기대된다.

엔비디아가 2H26 출시할 것으로 예상되는 베라 루빈은 CPU 베라 36개와 GPU 루빈 72개로 구성된다. 전작인 블랙웰 기반 플랫폼 대비 추론 성능이 5배 증가한 차세대 AI칩으로 알려져 있다. 베라 CPU에 LPDDRX를 기반으로 한 소캠2 모듈이 양옆에 4개씩 탑재된다. 소캠2 모듈은 16단으로 적층된 LPDDR5X를 4개로 붙인 구조이다. 소캠2 모듈 8개가 탑재되면 LPDDR5X 칩 수는 총 512개가 적용된다.

[그림 9] 삼성전자 소캠 2

자료: 삼성전자, 유안타증권 리서치센터

SoCAMM 관련 기업 동향

2024년 마이크론이 엔비디아로부터 소캠1 승인을 받아 주목받았다. 하지만, 엔비디아가 기술적 문제와 스펙 변경을 이유로 소캠1 프로젝트를 중단했다. 현재는 소캠2 개발이 진행되고 있다.

엔비디아. GTC 2026(3월 16일)에서 차세대 AI칩을 공개할 것으로 예상되며, 차세대 플랫폼인 베라 루빈 CPU에 소캠2가 탑재될 것으로 기대되고 있다.

삼성전자. 2025년 12월 18일 AI 데이터센터에 특화된 LPDDR 기반 서버용 메모리 모듈 소캠2를 개발하고 고객사 샘플 공급을 시작했다고 밝혔다. 2026년 3월 5일 삼성전자가 가장 먼저 192GB 제품 양산에 들어간 것으로 보도되었다. 삼성전자는 소캠2에 10나노급 5세대(1b) 공정을 적용하여, 베라 CPU 초기 제품에 소캠2를 탑재시킨 것으로 보인다.

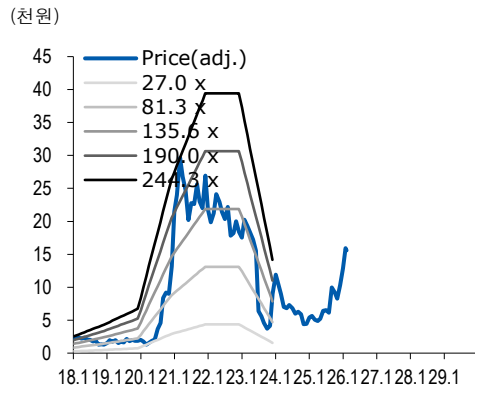
이로 인해 삼성전자의 소캠2가 엔비디아의 차세대 AI 가속기 베라 루빈의 초기 플랫폼에 가장 먼저 탑재, 향후 출시되는 후속 제품까지 공급 물량이 늘려 나갈 것으로 기대된다.

마이크론. 2026년 3월 3일 기존 발표한 192GB 소캠2보다 용량을 약 33% 개선시킨 256GB 소캠2를 업계 최초로 샘플을 출하했다고 밝혔다. 엔비디아와 협력을 하고 있다고 언급했다. 엔비디아 개발자 컨퍼런스 GTC 2026(3월 16~19일)에서 소캠2 제품을 공급할 예정이다.

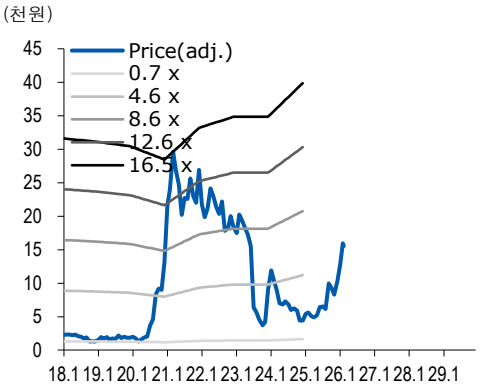
마이크론이 공개한 128GB 소캠2는 16 다이 LPDDR5X 스택 4개로 구성되어 있으며, 모듈 크기는 기존 RDIMM 대비 1/3수준이다. 소비전력은 동급 RDIMM대비 약 65% 절감되어, 전력효율이 중요한 AI 추론서버에 적합하는 평가이다.

SK하이닉스. SK하이닉스 소캠 기반 저전력 서버 메모리를 개발하고 있다. 2Q25 실적컨콜에서 연내 소캠2 샘플을 전달할 계획이라고 밝힌 바 있다. MWC 2026(3/2~3/5일)에서 주요 메모리 솔루션을 선보였다. AI 데이터센터와 서버 시장을 겨냥한 소캠2(192GB)와 HBM4 등이 전시되었다.

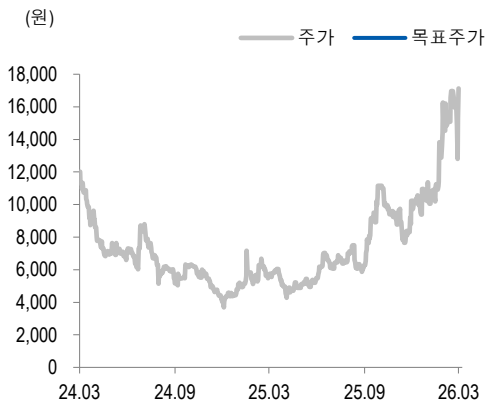
P/E band chart



P/B band chart



오킨스전자 (080580) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-03-10	Not Rated	-	1년		
2026-01-23	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 괴리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100

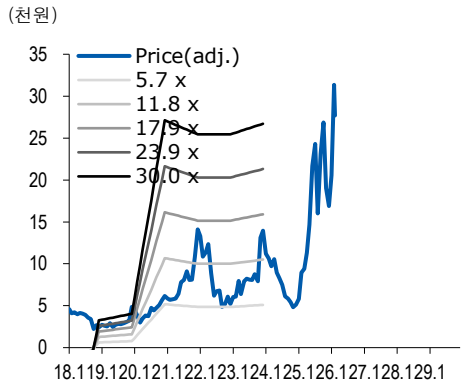
* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	94.8
Hold(중립)	5.2
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

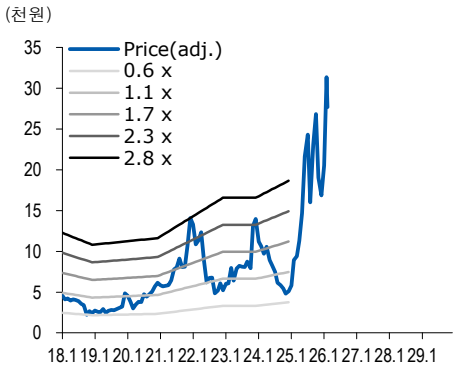
주: 기준일 2026-03-09

※해외 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

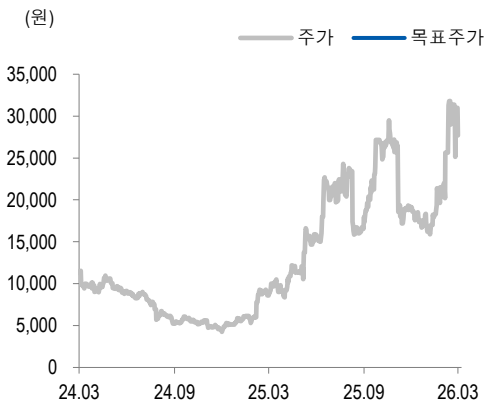
P/E band chart



P/B band chart



마이크로컨텍솔 (098120) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자의견	목표가(원)	목표가격대상시점	괴리율	
				평균주가대비	최고(최저)주가대비
2026-03-10	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 괴리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100

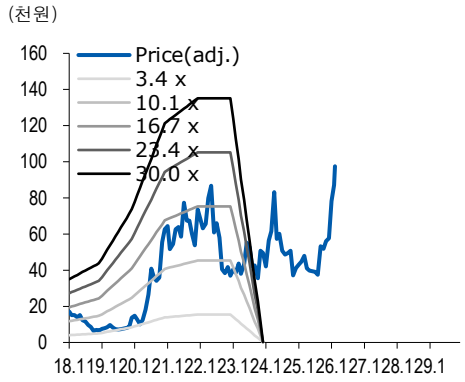
* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	94.8
Hold(중립)	5.2
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

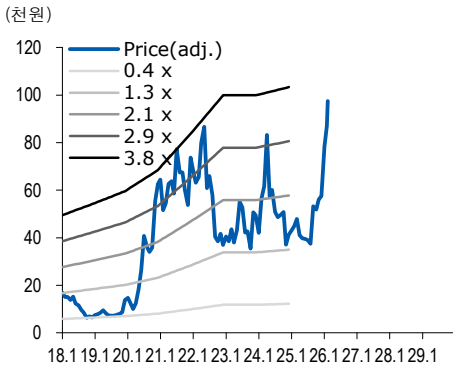
주: 기준일 2026-03-09

※해외 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

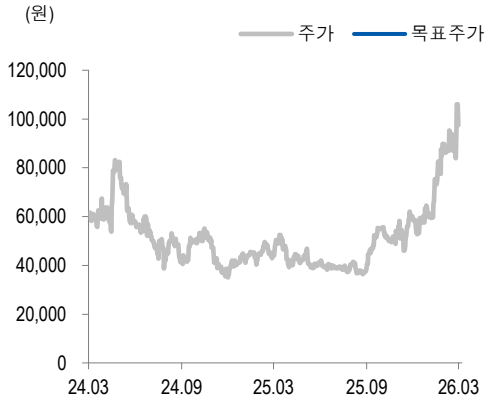
P/E band chart



P/B band chart



티에스이 (131290) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-03-10	Not Rated	-	1년		
2025-02-19	담당자변경 1년 경과 이후		1년		
2024-02-19	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 괴리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100

* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	94.8
Hold(중립)	5.2
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

주: 기준일 2026-03-09

※해외 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

Appendix

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. (작성자: **권명준**)
- 당사는 자료공표일 현재 동 종목 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 자료공표일 현재 해당 기업과 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다.
- 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료공표일 현재 대상법인의 주식관련 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 종목 투자등급 (Guide Line): 투자기간 12개월, 절대수익률 기준 투자등급 4단계(Strong Buy, Buy, Hold, Sell)로 구분한다
- Strong Buy: +30%이상 Buy: 15%이상, Hold: -15% 미만 ~ +15% 미만, Sell: -15%이하로 구분
- 업종 투자등급 Guide Line: 투자기간 12개월, 시가총액 대비 업종 비중 기준의 투자등급 3단계(Overweight, Neutral, Underweight)로 구분
- 2014년 2월21일부터 당사 투자등급이 기존 3단계 + 2단계에서 4단계로 변경

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.